

財團法人工業技術研究院 函

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號

承辦人：林秀姿

電話：03-5916636

傳真：03-5820466

E-mail：iris.lin@itri.org.tw



108002420206

31040 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 53 館 207 室

受文者：台灣太陽光電產業協會(TPVIA)

發文日期：中華民國 108 年 12 月 25 日

發文字號：工研轉字第 1080024202 號

速別：普通件

密等：無

附件：如文

主旨：本院擬舉辦「顯示、光通訊與構裝技術等相關專利非專屬授權案」之公開說明會，請轉知貴會會員把握機會參與本次推廣活動，請查照。

說明：

- 一、為提昇國內廠商智慧財產權能量，本院將舉辦「顯示、光通訊與構裝技術相關專利(25 案 58 件)非專屬授權案」公開說明會(詳如附件)。
- 二、有關本活動詳細資訊，請參考下列網站公告：
 - (一) 工研院研發成果公告網站
(<https://www.itri.org.tw/ListStyle.aspx?DisplayStyle=12&SiteID=1&MmmID=1036461244216621372>)
 - (二) 台灣技術交易資訊網
(<https://www.twtm.com.tw/Web/news/trans.aspx>)。
- 三、非專屬授權廠商資格：國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。
- 四、公開說明會：
 - (一) 舉辦時間：民國(下同) 109 年 1 月 16 日下午 3

時至 4 時。

(二) 舉辦地點：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110-1 室。

(三) 報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 109 年 1 月 14 日中午 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（主旨請註明「顯示、光通訊與構裝技術等相關專利非專屬授權案：公開說明會報名」，並於內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱）。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 109 年 1 月 15 日下午 5 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

五、聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心 林小姐

電話：(03) 591-6636

傳真：(03) 582-0466

電子信箱：iris.lin@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

正本受文者：台灣太陽光電產業協會(TPVIA)

院長



依權責劃分規定授權業務主管決行

108 年度工研院

顯示、光通訊與構裝技術等相關專利非專屬授權案

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）。

二、非專屬授權標的：顯示、光通訊與構裝技術等相關專利(25 案 58 件)，共分為六個類別：(一) 顯示技術(8 案 18 件)、(二) 光通訊技術(8 案 17 件)、(三) 光源模組技術(2 案 5 件)、(四) 晶圓級暨多晶片構裝技術(4 案 10 件)、(五) 功率模組技術(2 案 5 件) 及 (六) 檢測技術(1 案 3 件)。其中第 16 案為共有專利。

詳如下述網站：

(一) 工研院研發成果公告網：

<https://www.itri.org.tw/ListStyle.aspx?DisplayStyle=12&SiteID=1&MmmID=1036461244216621372>

(二) 台灣技術交易資訊網(TWTM)：

<https://www.twtm.com.tw/Web/index.aspx>

三、非專屬授權廠商資格：國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

四、公開說明會：

(一) 舉辦時間：民國（下同）109 年 1 月 16 日下午 3 時至 4 時。

(二) 舉辦地點：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110-1 室。

(三) 報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 109 年 1 月 14 日中午 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（主旨請註明「顯示、光通訊與構裝技術等相關專利非專屬授權案：公開說明會報名」，並於內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱）。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 109 年 1 月 15 日下午 5 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

五、聯絡人：工研院技術移轉與法律中心 林小姐

電話：+886-3-591-6636

傳真：+886-3-582-0466

電子信箱：iris.lin@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

附件：

非專屬授權標的 (25 案 58 件)

技術類別	案次	件次	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	申請號	專利證號	歸屬類別	發明/專	獨有/共有	專利起期	專利迄期
(一)顯示技術 (8 案 18 件)	1	1	P51000075TW	發光元件的轉移方法以及發光元件陣列	獲證	台灣	101118745	I521690	科專	發明	獨有	20160211	20320524
		2	P51000075CN	發光元件的轉移方法以及發光元件陣列	獲證	中國	201210258044.5	ZL201210258044.5	科專	發明	獨有	20151216	20320723
		3	P51000075USC1	發光元件的轉移方法以及發光元件陣列	獲證	美國	14/583,594	9,306,117	科專	發明	獨有	20160405	20320724
		4	P51000075USD1	發光元件的轉移方法以及發光元件陣列	獲證	美國	14/970,548	9,825,013	科專	發明	獨有	20171121	20320822
	2	5	P51010007TW	發光元件及其製造方法	獲證	台灣	102105341	I631697	科專	發明	獨有	20180801	20330207
		6	P51010007US	發光元件及其製造方法	獲證	美國	13/762,395	9,281,451	科專	發明	獨有	20160308	20330420
	3	7	P51010073TW	顯示面板	獲證	台灣	102119355	I483226	科專	發明	獨有	20150501	20330530
		8	P51010073US	顯示面板	獲證	美國	13/923,376	8,981,391	科專	發明	獨有	20150317	20330620
		9	P51010073USC1	顯示面板	獲證	美國	14/586,847	9,356,179	科專	發明	獨有	20160531	20330620
	4	10	P51030037CN	光電元件的轉移方法	獲證	中國	201410825883.X	ZL201410825883.X	科專	發明	獨有	20190503	20341224
	5	11	P51050031TW	電子元件的檢測方法及具有檢測元件的電子元件轉移模組	獲證	台灣	105124097	I578433	科專	發明	獨有	20170411	20360728
		12	P51050031USC1	電子元件的檢測方法及具有檢測元件的電子元件轉移模組	審查中	美國	16/430,447		科專	發明	獨有		
	6	13	P51050074TW	磁性轉移模組及轉移電子元件的方法	獲證	台灣	106112115	I605536	科專	發明	獨有	20171111	20370411
		14	P51050074US	磁性轉移模組及轉移電子元件的方法	審查中	美國	15/822,217		科專	發明	獨有		
	7	15	P51060034CN	發光結構的測試方法與發光裝置	審查中	中國	201711432504.0		科專	發明	獨有		
	8	16	P51990049TW	攝影投影裝置與發光感測模組	獲證	台灣	99140818	I465833	科專	發明	獨有	20141221	20301124
		17	P51990049CN	攝影投影裝置與發光感測模塊	獲證	中國	201110380159.7	ZL201110380159.7	科專	發明	獨有	20150513	20311124

技術類別	案次	序號	專利中文名稱	狀態	國家	申請號	專利權號	發明人	發明人姓名	專利權人	專利權人姓名	專利權人地址
		18	P51990049US	攝影投影裝置與發光感測模組	獲證	美國	13/304,706	9,357,188	科專	發明	獨有	20160531 20340408
(二)光通訊技術(8案17件)	9	19	P51070047TW	光學量測裝置與方法	獲證	台灣	107143321	1672480	科專	發明	獨有	20190921 20381202
		20	P51070047CN	光學測量裝置與方法	審查中	中國	201811548016.0		科專	發明	獨有	
		21	P51070047US	光學量測裝置與方法	暫准	美國	16/232,063		科專	發明	獨有	
		22	P51070047USD1	光學量測裝置與方法	暫准	美國	16/232,061		科專	發明	獨有	
	10	23	P51080021TW	主動式對位裝置	暫准	台灣	108211710		科專	新發明	獨有	
		24	P51080021CN	主動式對位裝置	審查中	中國	201921794913.X		科專	新發明	獨有	
	11	25	P51080022TW	測試裝置與異質整合結構	審查中	台灣	108136082		科專	發明	獨有	
		26	P51080022CN	測試裝置與異質整合結構	審查中	中國	201911146663.3		科專	發明	獨有	
	12	27	P51950096TW	光電基板	獲證	台灣	95139346	1306519	科專	發明	獨有	20090221 20261024
		28	P51950096CN	光電基板	獲證	中國	200610138108.2	ZL200610138108.2	科專	發明	獨有	20090708 20261108
		29	P51950096US	光電基板	獲證	美國	11/706,879	7,295,725	科專	發明	獨有	20071113 20270212
	13	30	P51950126TW	光電基板及其製造方法	獲證	台灣	95145496	1308228	科專	發明	獨有	20090401 20261205
		31	P51950126US	光電基板及其製造方法	獲證	美國	11/790,547	7,577,321	科專	發明	獨有	20090818 20270425
	14	32	P51960039TW	光電混載電路板及其製造方法	獲證	台灣	96124312	1393509	科專	發明	獨有	20130411 20270703
	15	33	P51970085TW	光波導結構及其製造方法	獲證	台灣	97144651	1393928	科專	發明	獨有	20130421 20281118
	16	34	P51980107TW	用於光學對準之結合系統	獲證	台灣	99122355	1418869	科專	發明	共有	20131211 20300706
		35	P51980107US	用於光學對準之結合系統	獲證	美國	12/778,127	8,265,436	科專	發明	共有	20120911 20300921
	17	36	P51040029TW	生物辨識裝置及方法與穿戴式載體	獲證	台灣	105120683	1623766	科專	發明	獨有	20180511 20360629

技術類別	案次	件次	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	申請號	專利證號	歸屬類別	發明/專	獨有/共有	專利起期	專利迄期
(三)光源模組技術(2案 5 件)	37	37	P51040029CN	生物辨識裝置及方法與穿戴式載體	審查中	中國	201610592548.9		科專	發明	獨有		
		38	P51040029USC2	生物辨識裝置及方法與穿戴式載體	審查中	美國	16/596,770		科專	發明	獨有		
		39	P51040029USC1	生物辨識裝置及方法與穿戴式載體	審查中	美國	15/730,687		科專	發明	獨有		
	18	40	P51040053TW	立體列印系統	獲證	台灣	104140607	I566918	科專	發明	獨有	2017 0121	2035 1202
(四)晶圓級暨多晶片構裝技術(4案 10 件)	19	41	P51010173TW	半導體元件	獲證	台灣	102111090	I488268	科專	發明	獨有	2015 0611	2033 0327
		42	P51990042CN	測量裝置	獲證	中國	201110160053.6	ZL201110160053.6	科專	發明	獨有	2014 0423	2031 0614
		43	P51990042US	測量裝置	獲證	美國	12/962,658	8,502,224	科專	發明	獨有	2013 0806	2031 0327
		44	P51990042USC1	測量裝置	獲證	美國	13/308,523	8,507,909	科專	發明	獨有	2013 0813	2031 0327
	21	45	P51060048TW	晶圓級晶片尺寸封裝結構	獲證	台灣	106146233	I662695	科專	發明	獨有	2019 0611	2037 1227
		46	P51060048CN	晶片級芯片尺寸封裝結構	審查中	中國	201810478854.9		科專	發明	獨有		
		47	P51060048US	晶圓級晶片尺寸封裝結構	審查中	美國	16/194,082		科專	發明	獨有		
	22	48	P51070059TW	異質整合組裝結構及其製造方法	審查中	台灣	108130777		科專	發明	獨有		
		49	P51070059CN	異質整合組裝結構及其製造方法	審查中	中國	201910802867.1		科專	發明	獨有		
		50	P51070059US	異質整合組裝結構及其製造方法	審查中	美國	16/553,179		科專	發明	獨有		
(五)功率模組技術(2案 5 件)	23	51	P51010186TW	高低壓隔離內埋功率模組	獲證	台灣	102121988	I516028	科專	發明	獨有	2016 0101	2033 0619
		52	P51010186CN	高低壓隔離內埋功率模塊	獲證	中國	201310316160.2	ZL201310316160.2	科專	發明	獨有	2017 0524	2033 0724
		53	P51010186US	高低壓隔離內埋功率模組	獲證	美國	14/018,434	9,143,243	科專	發明	獨有	2015 0922	2034 0506
	24	54	P51050064TW	智能型功率模組診斷系統及其方法	獲證	台灣	105137419	I598608	科專	發明	獨有	2017 0911	2036 1115
		55	P51050064US	智能型功率模組診斷系統及其方法	獲證	美國	15/352,989	10,288,696	科專	發明	獨有	2019 0514	2037 0707

技術類別	案文	序號	件號	專利中文名稱	狀態	國家	申請號	專利序號	類別	權利人	專利起期	專利迄期
(六)檢測技術 (1 案 3 件)	25	56	P51070001TW	電路板瑕疵篩選方法及其裝置與 電腦可讀取記錄媒體	獲證	台灣	107122979	I669519	科專	發明 獨有	2019 0821	2038 0702
		57	P51070001CN	電路板瑕疵篩選方法及其裝置與 計算機可讀取記錄介質	審查中	中國	201810995037.0		科專	發明 獨有		
		58	P51070001US	電路板瑕疵篩選方法及其裝置與 電腦可讀取記錄媒體	審查中	美國	16/134,986		科專	發明 獨有		

【備註】：本公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利之延續案、分割案、EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利、PCT 同一案所申請之各國專利。